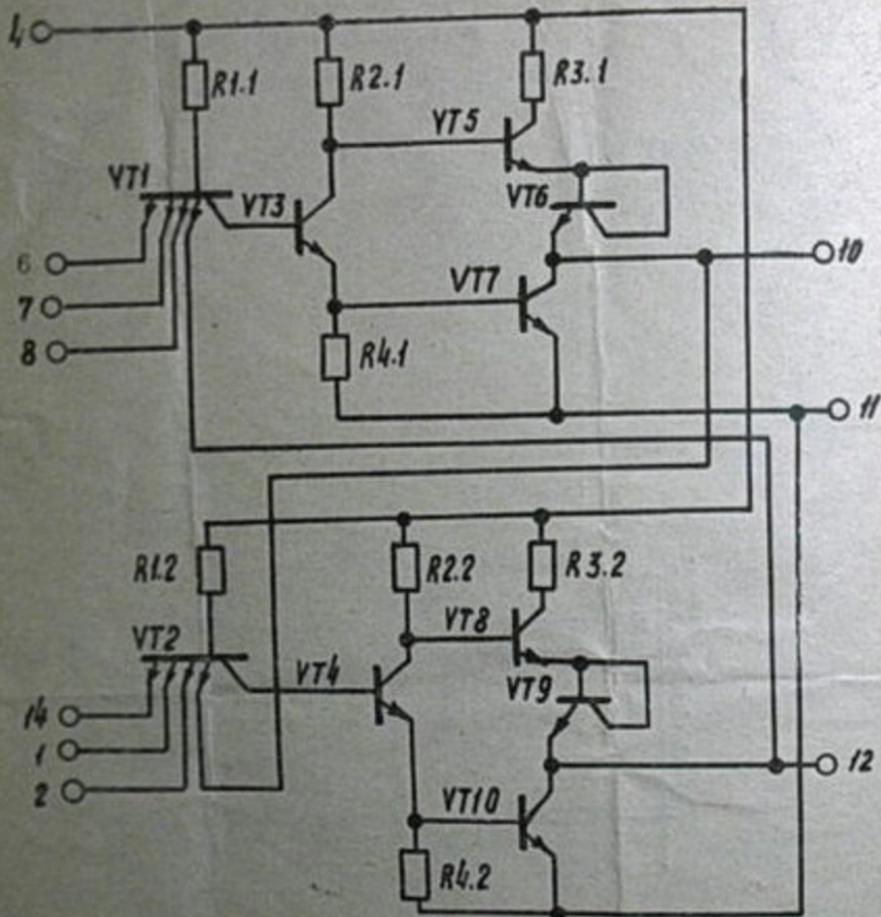


3. Электрическая схема.



4. Основные электрические параметры при $T_{amb} = 25^{\circ} \pm 10^{\circ}C$.

— выходное напряжение логического нуля не более 0,3В для К106ТР1; не более 0,35В для К106ТР1Б;

— выходное напряжение логической единицы не менее 2,3В для К106ТР1; не менее 2,1В для К106ТР1Б;

— максимальная средняя потребляемая статическая мощность 36 мВт;

— время задержки распространения информации $t_{зд.р.}^{1,0} \leq 80$ нс для К106ТР1;

— время задержки распространения информации $t_{зд.р.}^{1,0} \leq 120$ нс для К106ТР1Б;

Режим работы:

— напряжение питания $E_n = 5B \pm 10\%$;

— предельно допустимая мощность, выделяемая внутри корпуса без теплоотвода,
 $P_{\text{пр}} = 100 \text{ мВт}$.

5. Микросхема содержит золота 0,0147864 г, серебра 0,0011052 г. В микросхеме с крышкой без золочения содержится 0,0084299 г золота.

6. Указания по применению и эксплуатации:

а) в схеме аппаратуры запрещается подведение электрических сигналов (в том числе шин «корпус», «питание» и т.д.) к выводам микросхем, не используемым согласно принципиальной схеме данного типа;

б) проводить монтаж микросхем, находящихся только в обесточенном состоянии;

в) запрещается кручение выводов микросхем вокруг оси и изгиб выводов в плоскости корпуса микросхем;

г) рекомендации по формовке:

— минимальный радиус изгиба равен 0,36 мм;

— минимальное расстояние от корпуса до центра окружности изгиба равно 1 мм;

д) рекомендации по лужению методом погружения в расплавленный припой;

— температура расплавленного припоя не более 250°C;

— время погружения не более 2 с;

— расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм;

— допустимое количество погружений не более 2;

— интервал между двумя погружениями не менее 5 мин;

— припой и флюсы должны соответствовать требованиям стандартов или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке;

е) рекомендации по установке:

— установку микросхем на плату в аппаратуре производить с зазором от 0 до 0,7 мм с последующей прижимровкой или приклейкой клеем;

ж) рекомендации по пайке микросхем одножальным паяльником:

— температура жала паяльника не более 265°C;

— время касания каждого вывода не более 3 с;

— интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с;

— расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм;

— жало паяльника должно быть обязательно заземлено;

з) рекомендации по групповой пайке:

— температура жала группового паяльника не более 265°C;

— время воздействия (одновременно на половину или на все выводы) не более 2 с;

— расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм;

— интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы не менее 5 мин;

— жало группового паяльника должно быть обязательно заземлено;

и) рекомендации по очистке от флюса, влагозащите и приклейке:

— рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с требованиями стандартов или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке;

— рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231 или ЭП-730;

— приклейку рекомендуется производить клеями АК-20 или мастикой «ЛН»;

к) при работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуру должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов с величиной потенциала более 50В. С этой целью предприятию-потребителю необходимо:

— иметь производственную инструкцию, предусматривающую меры по уменьшению аккумуляции электростатических зарядов, согласованную с заводом-изготовителем микросхем;

— заземлить пицеты, металлические части стульев через сопротивление 1 МОм;

— заземлить жало паяльника.

Запрещается брать микросхемы руками.

Брать микросхемы только пицетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

л) во избежание нарушения целостности и герметичности корпуса микросхем при монтаже, демонтаже и в процессе работы с микросхемами не допускается деформация тела корпуса;

м) при формовке выводов микросхем участок вывода на расстоянии 1 мм от тела корпуса не должен испытывать усилий в плоскости, перпендикулярной оси вывода.

В связи с этим, при формовке выводов рекомендуется индивидуальное крепление выводов на участке от тела корпуса до места изгиба.

При формовке выводов величина растягивающего усилия, направленного вдоль оси вывода, не должна превышать 120 гс;

а) при работе микросхем в аппаратуре неиспользуемые входы одной ячейки (МЭТ) рекомендуется объединять с одним из используемых входов или подключать к источнику питания микросхем через резистор не менее 1 кОм, при этом можно объединять любое количество входов к одному и тому же резистору.

Неиспользуемые входы разрешается также подключать к выходам неиспользуемых выводов, при этом входы последних следует заземлять (подключать к уровню логического нуля).

Примечание: При объединении неиспользуемых входов с одним из используемых следует учитывать, что нагрузочная способность микросхем по уровню логической единицы определяется числом подключаемых входов.

7. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 45°C до +85°C;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°C—98%;
- вибрация с ускорением до 10g в диапазоне частот от 1 до 600 Гц;
- многократные удары с ускорением до 75g;
- линейные (центробежные) ускорения до 25g;

8. Время наработки 15 000 часов.

9. Срок хранения 6 лет.

10. Гарантия предприятия-изготовителя.

Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем потребителю.

11. Масса микросхемы не более 0,5 г.

12. Дата выпуска *11.78*

*МКС с одной любой точкой
замаркированы как 106 ТР1
соответствующей МКС
к 106 ТР1*

Штамп ОТК

ОТК76

ОТК76